

ほとんどの場合、金属間結合ができることにより、はんだ接続がなされます。

Cu を基材として考えた場合、共晶はんだで接合した場合、表 2 を見ると Cu と Sn では数種類の金属間化合物ができていることがわかりますが、Cu と Pb の欄は空白で、この組み合わせでは金属間化合物ができないことがわかります。すなわち Cu と共晶はんだの接続では Pb は関与せず、Cu と Sn の間にできる金属間化合物が接続の主役だということになります。これは鉛フリーはんだにおいても同じで、日本で主流の Sn-3Ag-Cu の鉛フリーはんだを考えると、表 2 の Ag と Cu の欄も空白で金属間化合物ができにくい組み合わせであることがわかります。Cu は基材と同じ成分なので感応しやすいですが、0.5wt%しかないので接続にはあまり寄与していません。すなわち鉛フリーはんだにおいても、接続は Sn が主役だということです。

表 2 では Cu と共晶はんだでは 2 種類の金属間化合物ができるようになっています。これは低温 (250~300°C) で Cu₃Sn (ϵ 相) と Cu₆Sn₅ (η 層) ができることを表しており、高温 (300°C) 以上になると Cu₃₁Sn₈ (γ 層) や (δ 層) ができるとされています。

合金層ができれば強い接合ができるというわけではありません。一般に金属間化合物は硬いのですが脆いのでその部分に力がかかると、割れやクラックが発生しやすくなるので、機械的強度の点で問題となります。また、導電性や耐食性も落ちるために金属間化合物の層が厚くなる事は良いことではありません。はんだ付けが容易だから、はんだ付け温度を上げすぎたり、はんだ付け時間を必要以上に長くしたりする事は決して良いことではありません。はんだの合金層は温度と圧力で変化するが、Cu と Sn の相図では低温で形成される (η 層) は 425°C で無くなるとされ、(δ 層) や (γ 層) は 350°C と 520°C 以上で形成されるとされています。

図 13 には Cu と共晶はんだにおいて各温度加熱 3 分で金属間化合物の厚さを示します。温度により結晶相と厚さが変わるのがわかります。

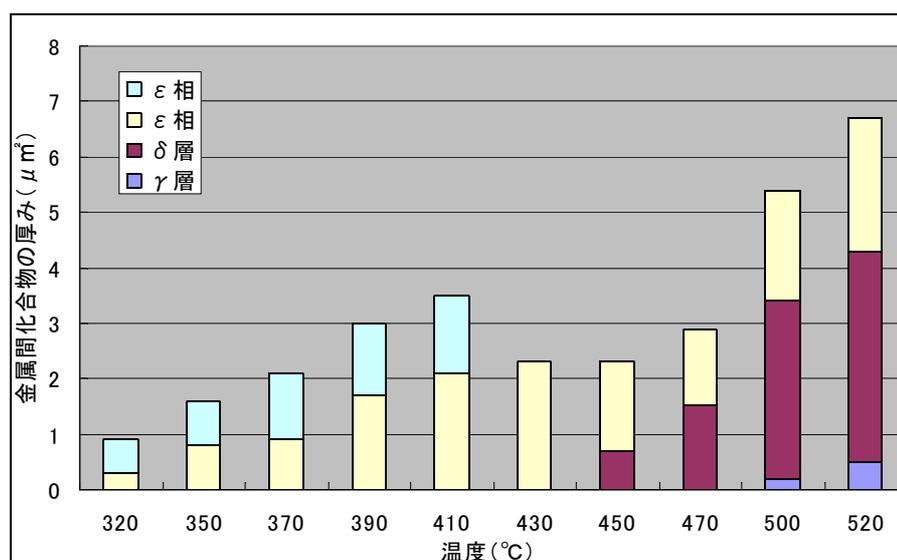


図 13. Cu と Sn で形成された金属間化合物の厚さと温度の関係